

# Cu-OF

Bezeichnung	EN / Cu-OF	EN / CW008A	UNS / C10200
-------------	------------	-------------	--------------

Diese hochreine Kupfersorte ist sauerstofffrei und findet ihren Einsatz vor allem in Bereichen wie Hartlötungen und in Hochvakuum-Anwendungen. Cu-OF ist resistent gegen „Wasserstoffkrankheit“ und frei von im Vakuum verdampfenden Elementen. Aus diesem Material können sehr dünne Kupferfolien gefertigt werden.

## ZUSAMMENSETZUNG

- Cu:  $\geq 99,95\%$     • O:  $\leq 0,001\%$

## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

· Dichte	8,93 g/cm <sup>3</sup>
· Schmelzpunkt	1083 °C
· Elektrische Leitfähigkeit	min. 58 m/Ω mm <sup>2</sup> (bei 20 °C R200)
· Spezifischer elektrischer Widerstand	max. 0,017241 Ω mm <sup>2</sup> /m (bei 20 °C R200)
· Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes	3,81·10 <sup>-3</sup> /K (bei 0 bis 200 °C R200)
· Wärmeleitfähigkeit	394 W/K m (bei 20 °C)
· Spezifische Wärmekapazität	0,386 J/g K (bei 20 °C)
· Wärmeausdehnungskoeffizient	17,7·10 <sup>-6</sup> /K (bei 20 bis 300 °C)
· Elastizitätsmodul	110 GPa (bei 20 °C R200)

LIEFERFORM	DICKE	BREITE
Rollen, Spulen, Ringe, Formate	0,006 - 0,4 mm	0,6 - 660 mm

*nicht alle Kombinationen aus Dicke und Breite sind möglich  
Bei abweichenden Abmessungen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Service*

ZUSTAND NACH DIN EN 13599			TYPISCHE WERTE (nur zu Info)
	Zugfestigkeit Rm in MPa	Streckgrenze Rp0,2 in MPa	Dehnung in % L <sub>0</sub> = 100 mm
R200	200 - 250	≤ 100	> 15
R220	220 - 260	≤ 140	> 15
R240	240 - 300	≥ 180	< 35
R290	290 - 360	≥ 250	< 20
R360	≥ 360	≥ 320	< 5

Tabellenwerte gelten für Folien > 0,1 mm Dicke

Weitere Infoblätter finden Sie auf unserer Webseite: <https://www.schlenk.com>  
Weiterführende Informationen finden Sie beim Deutschen Kupferinstitut: <https://www.kupferinstitut.de>